

Title (en)

Ceiling, wall or floor panel for fire protection purposes

Title (de)

Unterdecke, Wand- oder Bodenplatte für Brandschutzzwecke

Title (fr)

Panneau coupe-feu de plafond, paroi ou plancher

Publication

EP 1705304 A2 20060927 (DE)

Application

EP 06014791 A 20030513

Priority

- EP 03010652 A 20030513
- DE 10223904 A 20020529

Abstract (en)

The under-cover, wall and base plate comprises a multi-layer wall, a floor or ceiling element (1) made from a fire or heat resistant protective material. The element has a holding carrier construction with an opening for arrangement of installation sections of electrical components. In the vicinity of the opening is a pot-like formed section (4) that has an insulation layer (5). The layer inflates under operating heat or fire and /or forms a carbon layer. The inner chamber of the formed side of the element is accessible and holds installation sections of electrical components (2, 3).

Abstract (de)

Um eine Unterdecke, Wand oder Bodenplatte für Brandschutzzwecke, bestehend aus einem vorzugsweise mehrlagig ausgebildeten Wand-, Boden- oder Deckenelement (1) aus einem feuer- und hitzebeständigen Brandschutzmaterial, sowie einer das Element (1) haltenden Tragkonstruktion, wobei das Element (1) mit einer Öffnung zur Anordnung von Installationsteilen oder elektrotechnischen Bauteilen, versehen ist, wobei im Bereich der Öffnung ein topfartiges Formteil (4) angeordnet ist, welches ein eine Dämmschicht bildendes Material (5) aufweist, welches unter der Einwirkung Hitze und/oder Feuer aufbläht und/oder eine Karbonsperrschicht bildet, wobei der Innenraum des Formteiles (4) von der Vorderseite des Elementes (1) zugänglich und zur Aufnahme von Installationsteilen der elektrotechnischen Bauteilen (2,3) bestimmt ist, zu schaffen, bei der mit einfachen, seriell gefertigten Elementen die Anordnung von Installationsteilen oder von elektrischen Einbauteilen, vereinfacht ist, wird vorgeschlagen, dass das die Dämmschicht bildende Material (5) in Form eines formhaltigen Körpers ausgebildet ist, der in oder auf das Formteil (4) eingebracht oder aufgebracht ist.

IPC 8 full level

E04B 9/00 (2006.01); **F21S 8/02** (2006.01); **F21V 25/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

E04B 9/001 (2013.01); **E04B 9/006** (2013.01); **F21S 8/02** (2013.01); **F21V 25/00** (2013.01)

Cited by

EP1911902A3

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1367191 A1 20031203; **EP 1367191 B1 20070627**; AT E365841 T1 20070715; DE 10223904 A1 20031211; DE 50307546 D1 20070809; EP 1705304 A2 20060927; EP 1705304 A3 20090617

DOCDB simple family (application)

EP 03010652 A 20030513; AT 03010652 T 20030513; DE 10223904 A 20020529; DE 50307546 T 20030513; EP 06014791 A 20030513